

2022年5月13日

各 位

J X 金属株式会社

米国アリゾナ州における新工場建設に係る資金調達の実施について

J X 金属株式会社（社長：村山 誠一、以下「当社」）のグループ会社である JX Nippon Mining & Metals USA, Inc.（CEO：桑原 真砂、以下「JXUSA 社」）は、株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：前田 匡史）との間で融資契約を締結しました。本融資は、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行との協調融資により実施されます。本件は、当社が JXUSA 社を通じて推進する米国での半導体用スパッタリングターゲット事業の強化などに必要な資金を調達するものです。

当社の半導体用スパッタリングターゲットは先端半導体の微細配線の形成に欠かせない材料です。JXUSA 社は半導体産業が集積する米国アリゾナ州に位置し、米国における同製品の加工および販売を担っています。

現在、デジタルトランスフォーメーションや脱炭素化に向けた動きの加速などにより、半導体産業の拡大が急速に進んでおり、先端半導体メーカーが相次いで米国での投資を計画しています。かかる状況を踏まえ、当社は JXUSA 社を通じてアリゾナ州内に同社の現行の生産拠点の約 6 倍の広さの土地を取得し、同製品の生産能力を顧客ニーズに応じて機動的に拡大することといたしました（※）。本融資を活用しつつ当施策を遂行することにより、国内産業全般にわたる国際競争力の維持・向上や、半導体産業のサプライチェーン強靱化に貢献してまいります。

また、今後当社グループでは、同地を半導体用スパッタリングターゲットの拠点としてだけでなく、北米における先端事業分野の中心地としていく予定です。

これからも当社グループは、「2040 年 J X 金属グループ長期ビジョン」で掲げる「技術立脚型企業」への転身に向けた施策を推し進め、先端素材で社会の発展と革新に貢献するグローバル企業を目指してまいります。

以上

（※）2022 年 3 月 10 日付当社プレスリリース「米国アリゾナ州における用地取得について」をご参照ください。